SIEMENS

Лист тех. данных — 6ES7590-0BH00-0AA0

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; активная задняя шина (8 слотов) для установки модулей S7-1500, горячая замена модулей для ET 200MP с IM 155-5 PN HF (начиная с FW V4.4.1); профильная шина S7-1500 и крышки слотов должны быть заказаны отдельно



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	активная задняя объединительная панель ST, 1+8 слотов
Функциональный стандарт HW	Не ниже FS01
Версия микропрограммного обеспечения	V1.0.0
● Возможно обновление микропрограммного обеспечения	Да
Функция продукта	
● Данные для идентификации и техобслуживания	Да; I&M0 - I&M3
● Режим тактовой синхронизации	Да
● Пуск согласно приоритету	Да
Инженерное обеспечение с помощью	
● STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	V16
● STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	с V5.6
● PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision	V2.35 / -
Мощность	
Потребляемая мощность шины на задней стенке	2 W
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	2 W
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Гнезда	
● Размер растра	35 mm; Возможно использование модулей шириной 25 мм
● Число гнезд	9
— в т. ч. для CPU, макс.	0
— в т. ч. для IM, макс.	1
— в т. ч. для PS, макс.	2; макс. 2 PROFIsafe на подстанцию
— в т. ч. для IO/CM/CP/TM, макс.	8
— в т. ч. для F-IO, макс.	8
● Макс. число гнезд одинарной ширины	8
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
● вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● вертикальный настенный монтаж, макс.	40 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	-40 °C
● макс.	70 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	

● Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание
Размеры	
Ширина	294 mm
Высота	99 mm
Глубина	14 mm
Массы	
Масса, прибл.	245 g